

## 概要

この通知は、ザイリンクス Platform Flash PROM をご使用のお客様に鉛フリー 48TFBGA (FSG48) パッケージのはんだボールの構成材質が変更されることをお知らせするものです。

## 詳細説明

ST Microelectronics 社製 Platform Flash PROM のパッケージ アセンブリ材質が変更されます。48 TFBGA (FSG48) パッケージでは SAC+ はんだボールに代わり、SACN はんだボールが使用されます。製造過程およびその制御方法は現行どおりです。BGA パッド合金 (CuOSP) に変更はありません。この変更は、次の理由により実施されます。

- 鉛フリーはんだボールを RoHS 要件に準拠させる：鉛 (Pb) およびアンチモン (Sb) は使用しない。
- 新しい SACN ボール合金によって BGA 上でののはんだボールのボンディング強度を増加させる。SAC+ よりも延性に優れたボールを使用することで、BGA 側における金属間強度を補強する。
- ボード レベルの信頼性を一層向上させる。
- マトリックス BGA で使用される業界共通の SACN 合金に標準化する。

SACN とは Sn (スズ) - Ag (銀) - Cu (銅) - Ni (ニッケル) を指します。

Ni は (Cu, Ni) 6Sn5 金属間に凝縮するドーパントとして使用されます。

## 該当製品

この変更は、次の 48 FBGA Platform Flash デバイスに該当します。

表 1：SACN はんだボールの変更が該当する Platform Flash デバイス

Platform Flash デバイス	
XCF08PFSG48C	XCF08PFSG48C0973
XCF16PFSG48C	XCF16PFSG48C0973
XCF32PFSG48C	

## キー デート

SACN はんだボールを使用した FSG48 製品の最初の出荷デート コードは、2007 年の WW19 を予定しております。

## お問い合わせ

融解温度は、現在の SAC はんだボールよりも SACN FSG48 はんだボールの方が高温となります。鉛フリー製品で共晶はんだのリフロー プロファイルをご使用の場合、SACN はんだボールの融解温度を JEDEC-20C 仕様内でより高温に修正する必要がある場合があります。現在の SAC+ 合金の溶解温度は 218 ~ 222 で、新しい SACN 合金では 220 ~ 226 です。これらの範囲は共に JEDEC-20C 仕様を完全に満たしています。

はんだボールの構成材質の変更は、FSG48 パッケージ構成の信頼性に影響を与えません。ご不明な点、ご質問等がございましたら、[ザイリンクス テクニカル サポート](#)までお問い合わせ下さい。

**重要なお知らせ：**カスタマ変更通知 (PCN、PDN、Quality Alert) は、弊社のサポート ウェブサイト

<http://japan.xilinx.com/support/mysupport.htm> から e-mail によるアラート配信として受信できます。まず、アラートにご登録後、My アラートにカスタマ変更通知が含まれるようカスタマイズして下さい。これにより、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーション ノートなどに関するアラートを受け取ることができるようになります。登録方法は、[ザイリンクス アンサー 18683](#) を参照して下さい。

## 改訂履歴

次の表に、この通知の改訂履歴を示します。

日付	バージョン	変更内容
2007/01/01	1.0	初版リリース

この通知は、英語版 (XCN06024、バージョン 1.0、2007 年 1 月 1 日発行) を翻訳したものです。